

DIN 6113-5

ICS 35.240.60; 55.140

**Verpackung –
Elektronische Identifikation von starren Industrieverpackungen,
Positionierung und Systemparameter für passive RFID-Chips –
Teil 5: Kunststoffspundfass und Kunststoffdeckelfass mit Spund mit
einem Nennvolumen größer als 200 l**

Packaging –

Radio-frequency identification of rigid industrial packaging, positioning and system parameters for passive RFID chips –

Part 5: Non-removable head (tight head) plastics drum and removable head (open head) plastics drum with plug/bung closure system of nominal capacity exceeding 200 l

Emballage –

Identification électronique d'emballages rigides industriels par radiofréquence, positionnement et paramètres du système pour puces RFID passives –

Partie 5: Fût en plastique à ouverture partielle et fût en plastique à ouverture totale à bonde d'une capacité nominale supérieure à 200 l

Gesamtumfang 3 Seiten

Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN
Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA) im DIN

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 115-02-03 AA „Spund- und Deckelbehältnisse“ bzw. im Arbeitskreis NA 115-02-03-01 AK „RFID auf starren Industrieverpackungen größer als 60 Liter“ des Normenausschusses Verpackungswesen (NAVp) erarbeitet.

DIN 6113 *Verpackung — Elektronische Identifikation von starren Industrieverpackungen, Positionierung und Systemparameter für passive RFID-Chips* besteht aus den folgenden Teilen:

- *Teil 1: Allgemeines*
- *Teil 2: Stahlspundfass und Stahldeckelfass mit Spund mit einem Gesamtvolumen größer als 200 l*
- *Teil 3: Stahldeckelfass ohne Spund mit einem Gesamtvolumen größer als 200 l*
- *Teil 4: Fibertrommel mit einem Nennvolumen bis 250 l*
- *Teil 5: Kunststoffspundfass und Kunststoffdeckelfass mit Spund mit einem Nennvolumen größer als 200 l*
- *Teil 6: Kunststoffdeckelfass ohne Spund mit einem Nennvolumen größer als 200 l*
- *Teil 7: Kombinations-IBC*